

# 株式会社テラプローブ 決算説明資料

2013年3月期 第3四半期

2013年3月期第3四半期  
業績説明

## 今回の発表の概要

### メモリ事業

- テスト時間の長いモバイル向けDRAMはYoY売上増だが、QoQでは売上微減
- テスト時間の短い汎用DRAMはYoY、QoQとも売上減

### システムLSI事業

- テスト受託は、YoYでは微減、QoQでは同水準
- ウエハレベルパッケージ(WLP)はQoQでは売上微減 (YoYでは純増)



**2Q比、費用削減(約2億円)を進めるが、  
売上高の減少(約6億円)を補いきれず、QoQでは減収減益**

## 2012年度第3四半期 実績

(億円)

		四半期(累計)実績前年同期比較			四半期実績前四半期比較		
		1-3Q/FY2011	1-3Q/FY2012	YoY増減	2Q/FY2012	3Q/FY2012	QoQ増減
売上高	メモリ	151.4	115.1	-36.3	39.8	34.2	-5.6
	システムLSI	29.0	48.0	19.0	14.3	13.6	-0.7
	その他	-0.7	-0.2	0.5	-0.2	-0.0	0.2
売上高		179.7	162.8	-16.9	53.9	47.8	-6.1
営業利益	メモリ	39.9	14.3	-25.6	6.1	2.0	-4.1
	システムLSI	-6.4	-2.1	4.3	-1.5	-2.0	-0.5
	その他	-9.2	-10.8	-1.6	-3.7	-3.3	0.4
営業利益		24.3	1.4	-22.9	0.9	-3.3	-4.2
営業利益率		14%	1%	—	2%	—	—
当期純利益		13.3	1.4	-11.9	1.1	-2.3	-3.4
当期純利益率		7%	1%	—	2%	—	—

※3Q/FY2011よりシステムLSI事業にWLPが含まれております

## 第3四半期実績増減分析(売上高)

### 1-3Q実績(YoY)

#### <メモリ事業>

- ・モバイル向け製品は、受託数量の増加により売上高も増加
- ・PC向け製品は、数量の大幅減少により売上高が大きく減少

#### <システムLSI事業>

- ・テラミクロスの連結子会社化等によりWLP分が売上増加

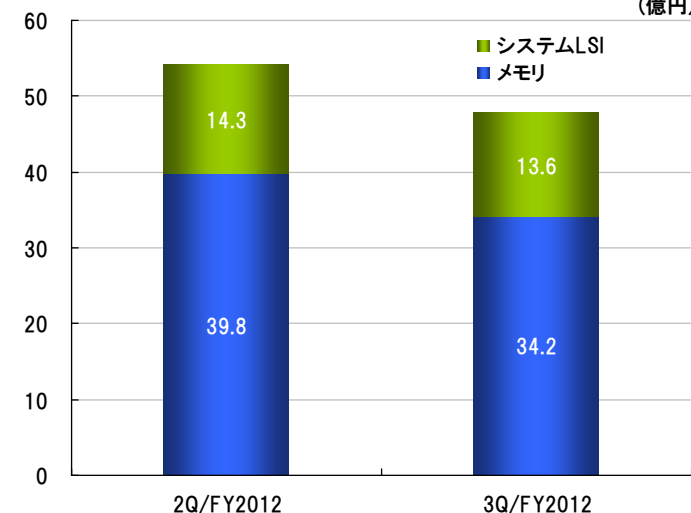
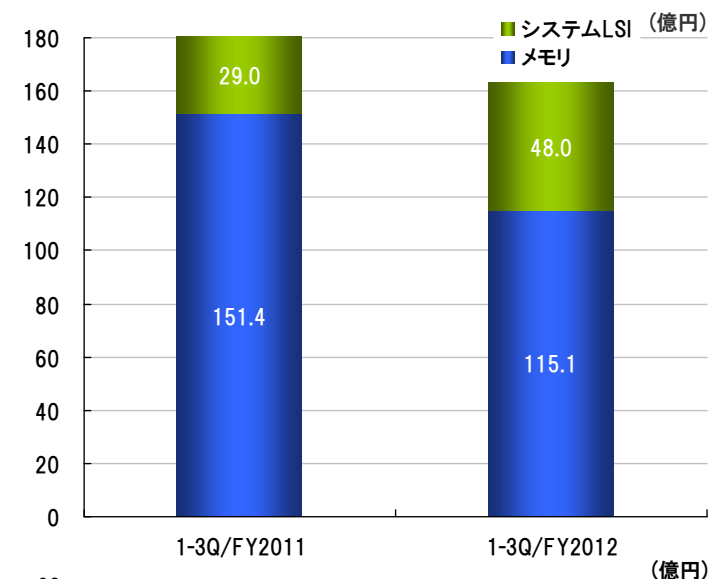
### 3Q実績(QoQ)

#### <メモリ事業>

- ・モバイル向け製品は売上高が微減、PC向け製品は更なる受託数量の減少で売上高減少

#### <システムLSI事業>

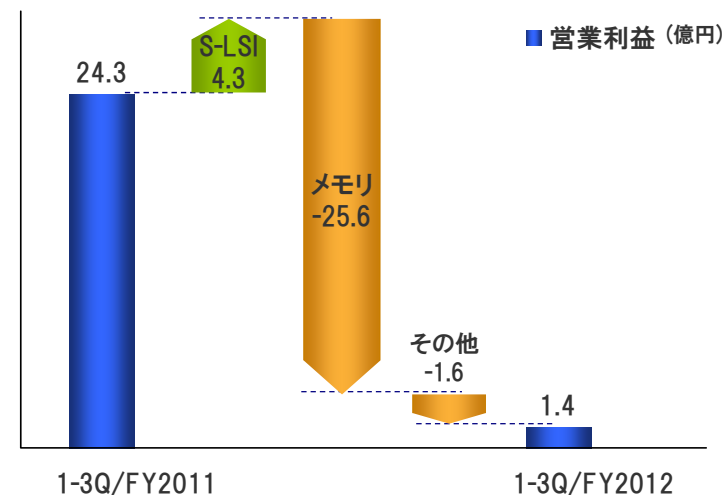
- ・センサー向けテスト受託が増加したものの、WLPの受託減少により微減



## 第3四半期実績増減分析(営業利益)

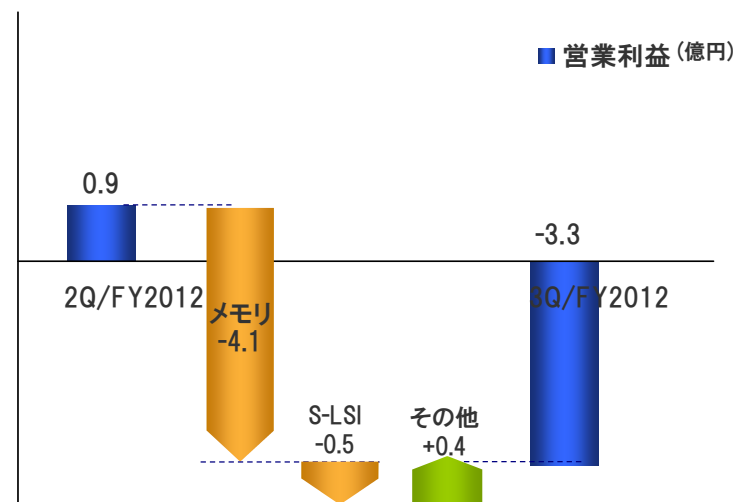
### 1-3Q実績(YoY)

- ・メモリ事業は費用削減約10億円したが、売上高約36億円減少し、約25億円の損益悪化
- ・システムLSI事業(テスト)は費用削減により損益改善



### 3Q実績(QoQ)

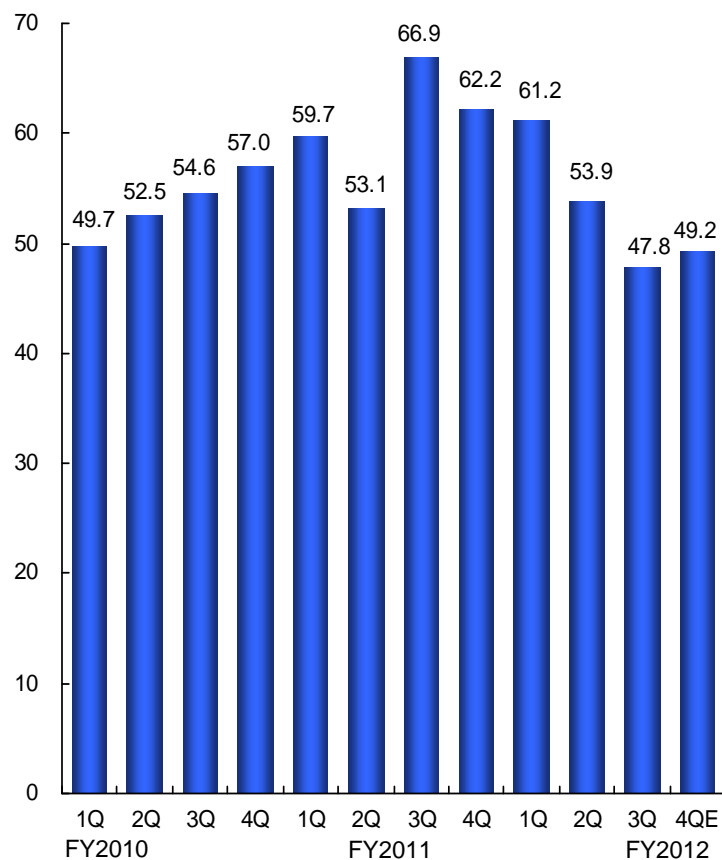
- ・メモリ事業はPC向け製品の受託減少に伴う売上高減少により損益悪化
- ・システムLSI事業はテスト受託は横ばいで推移したものの、WLPの受託減少により損益悪化



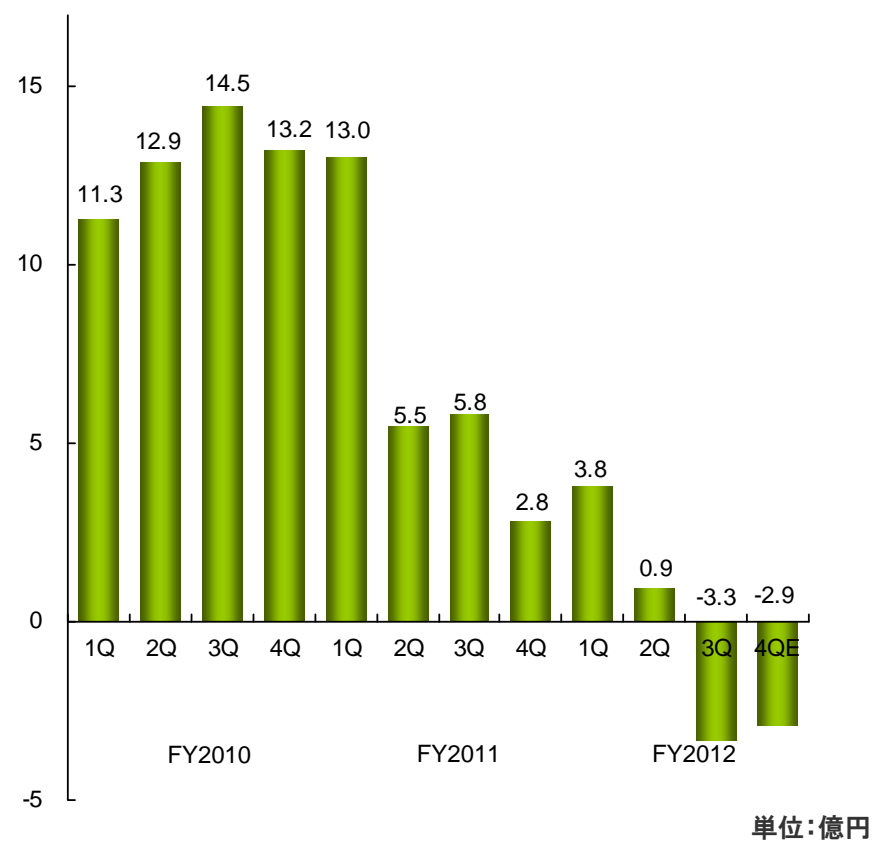
# 2013年3月期第4四半期業績予想

# 売上高及び営業利益推移

## 売上高推移



## 営業利益推移

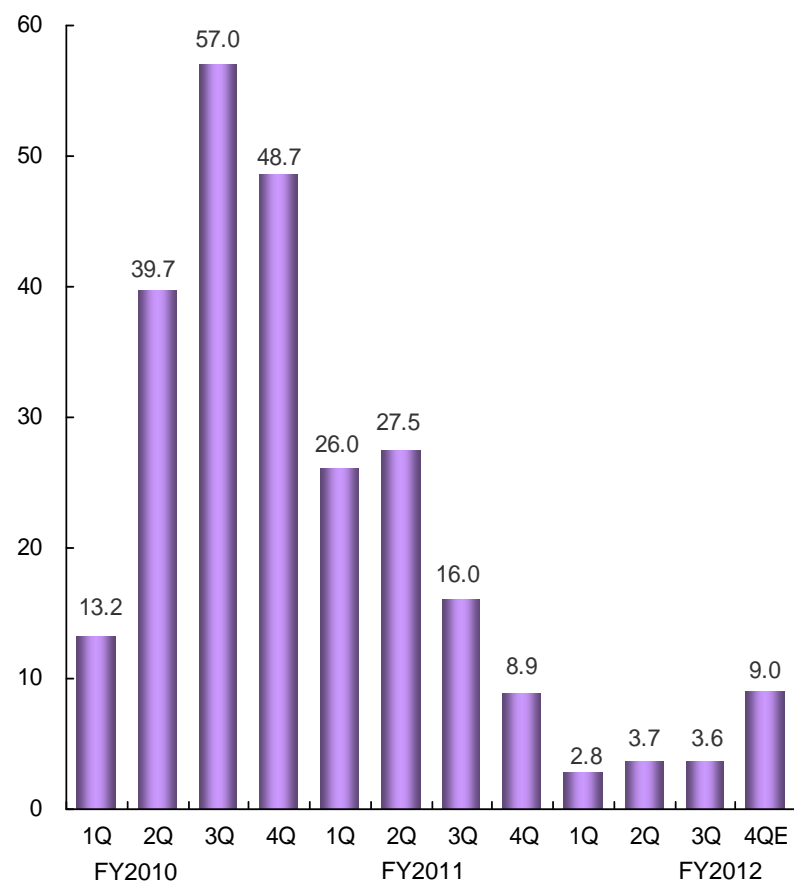


当社グループが属する半導体業界は市場環境が短期間に変化するという特徴があり、1年間の業績予想を作成することが困難であることから、連結業績予想は翌四半期のみを開示することといたします。

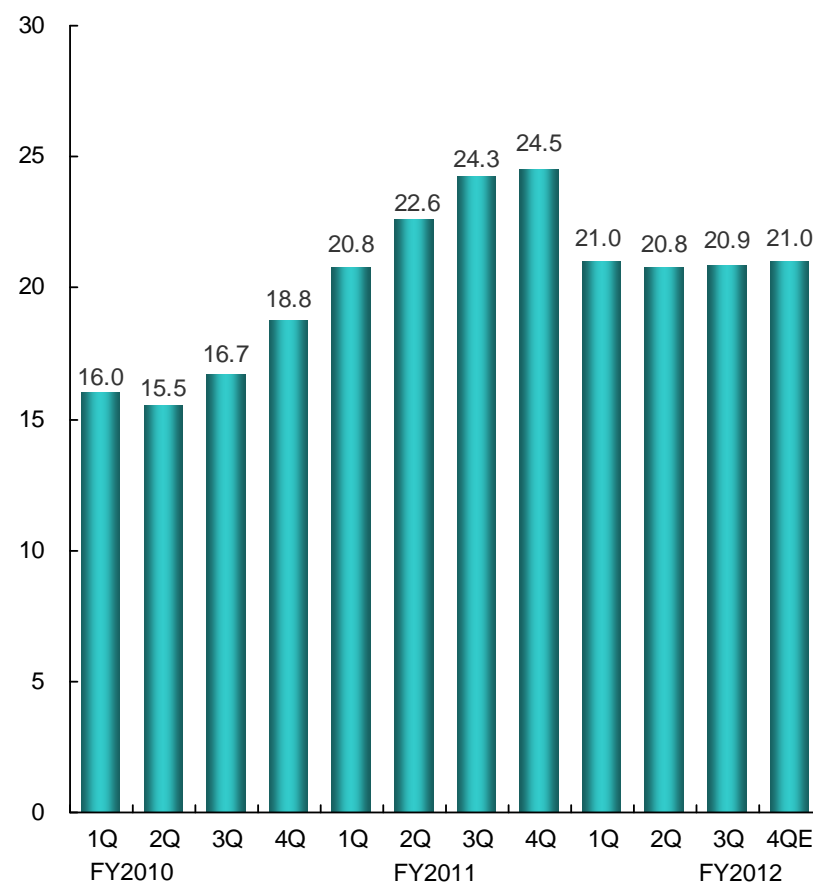


# 設備投資及び減価償却

## 設備投資額推移



## 減価償却費推移



単位: 億円

## 第4四半期業績予想の概要

### メモリ事業

- モバイル向け製品は引き続き堅調に推移
- PC向け製品は低調に推移

### システムLSI事業

- テスト受託は順調に推移
- WLP受託は新規品の受託開始もあり、緩やかに回復



**新規受託の推進、費用削減を進めるが受託数の回復が緩やかで、前四半期からほぼ横ばいと予想**

# 会社説明資料

## 会社概要

社 名	株式会社 テラプローブ（英文名称:Tera Probe, Inc.）
本 社 所 在 地	神奈川県 横浜市 港北区 新横浜二丁目7番17号
代 表 者	代表取締役社長 渡辺 雄一郎 代表取締役副社長 小平 広人
設 立	2005年8月
事 業 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ メモリ事業 (DRAM等のメモリ製品のウエハテスト、ファイナルテスト、 開発受託及びWLP受託)</li> <li>・ システムLSI事業 (SoC、イメージセンサ、アナログ等の各種半導体製品 のウエハテスト、ファイナルテスト、開発受託及びWLP受託)</li> </ul>
資 本 金	11,823百万円
連 結 子 会 社	TeraPower Technology Inc.（半導体ウエハテスト受託） 株式会社テラミクロス（ウエハレベルパッケージ受託）
従 業 員 数	320名(単体)、668名(連結)

2012/12末現在

# 事業拠点

The map shows Japan in blue with red dots indicating domestic locations: Kyushu, Kansai, and Kanto. Taiwan is shown in blue with a red dot indicating an overseas location. Lines connect these dots to detailed callout boxes.

### 海外拠点 (台湾)

TeraPower Technology Inc. (台湾新竹縣)

- 台湾のテスト拠点

### 国内拠点

#### 本社・開発センター (神奈川県横浜市)

#### Teramikros (東京都青梅市)

- WLPの生産拠点

#### 九州事業所 (熊本県葦北郡)

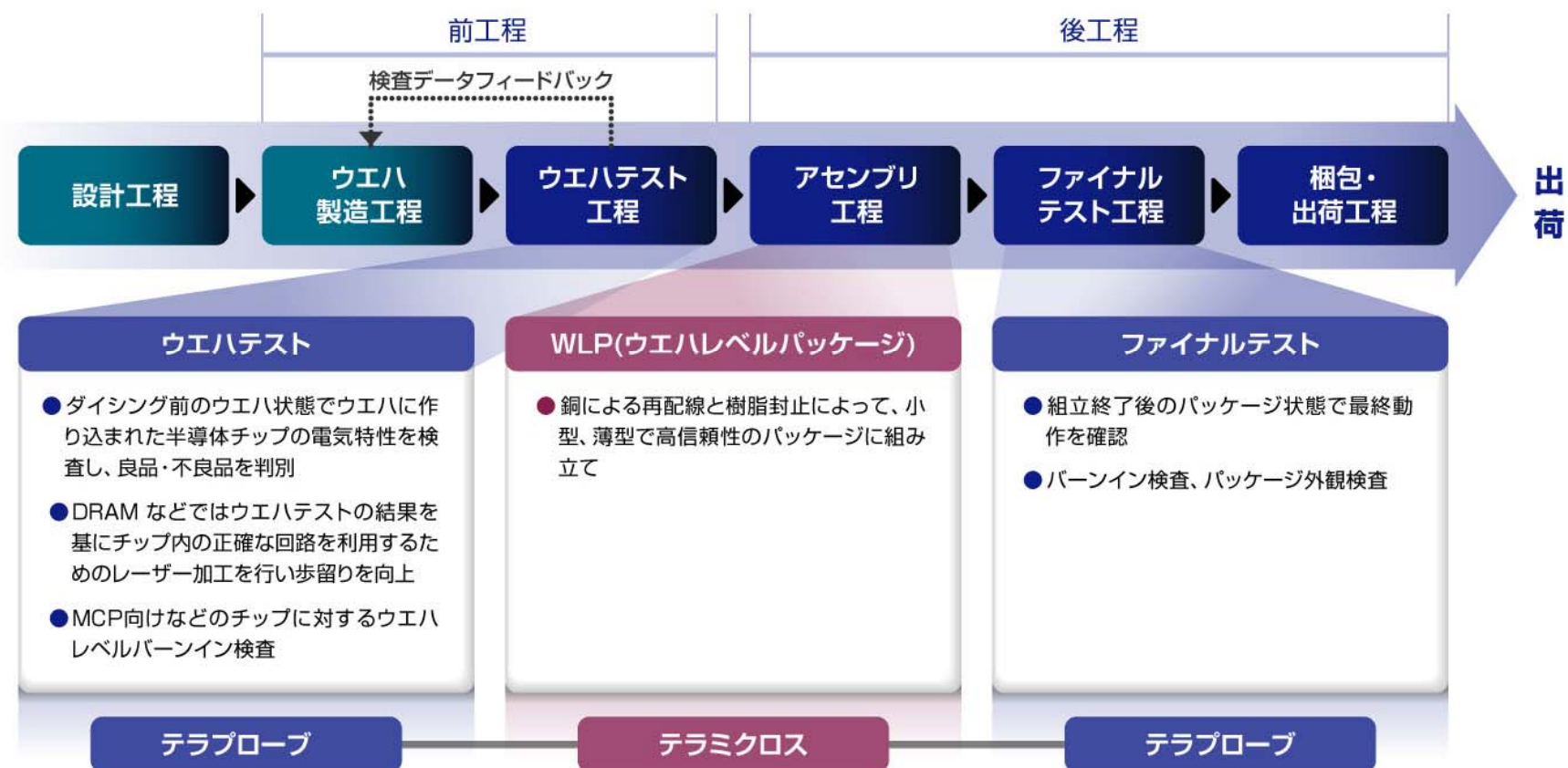
- SoC、イメージセンサ、アナログ等のテスト拠点

#### 広島事業所 (広島県東広島市)

- メモリ系のテスト拠点

## 半導体製造工程における当社事業の役割

- テストオペレーションの他、治工具の設計、テストプログラムの開発、製品レイアウトへのアドバイスまで
- 半導体製造のバックエンド（後工程）ターンキーサービスにより、顧客の利便性を向上



バックエンドターンキーサービスとは、顧客がウエハ検査後の全ての工程を一括で委託することで、品質、納期等の管理を一元化できるサービスです。

## 本資料における注意事項等

- 本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社テラプローブ(以下、弊社)の現状を理解していただくために作成したものです。
- 本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
- 投資を行う際は、必ず弊社が作成する「平成25年3月期第3四半期決算短信」をご覧ください。また、投資家ご自身の判断において行っていただきますよう、お願いいたします。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社テラプローブ  
コーポレートプランニング・IR部門  
TEL (045)476-5711  
URL <http://www.teraprobe.com>